



# 鸿富诚

专业·专心·专注

创新功能材料领军企业

## HTG-100DK 常规系列

### 【双组份导热凝胶】规格书



-产品图-

#### 应用特点：

- 1.0(±0.1)W/m.K 导热系数
- 以不定形状替代传统的组装式片材
- 可通过各种手工或自动化的工艺进行点胶
- 柔软，可消除装配应力，减震阻尼
- 固化后可保持所需厚度

#### 应用领域推荐：

- 半导体块和散热器
- 用于LED灯具和发光体、汽车和消费领域
- 点胶或直接涂覆成各种厚度和形状
- 高性能中央处理器及显示卡处理器

#### 应用方式：

双组份导热凝胶可通过各种方式使用，包括：自动点胶、手动涂覆。

#### 包装：

根据不同需求，可以按照400cc双管或20L桶装等容量，按照1：1的方式进行灌注包装。

该系列产品环保符合RoHS2.0、卤素、REACH标准。

#### 储存条件：

- 阴暗处储存，
- 储存温度：≤30℃；
- 储存湿度：≤70%；

#### 保质期：

- 在储存条件下：半年
- 不符合储存条件下：三个月

鸿富诚 HTG-100DK系列 双组份导热凝胶，是一种可常温固化的导热膏状物，固化后呈现一种柔韧的橡胶弹性体，适用于有散热需求的电子/电气领域，特别适用于不同元器件共用一个散热器大间隙的场合，可自动点胶，以实现自动化作业。

#### 产品性能

NO.	参数	单位	测试方法
颜色	A组分	白色	--
	B组分	灰色	--
	混合后	灰白色	--
粘度	A组分	90000 (@7#20rpm)	mPa·s
	B组分	120000 (@7#20rpm)	mPa·s
密度	1.8(±0.2)	g/cc	ASTM D 792
混合比例	1:1	--	质量比
挤出速率 @0.25Mpa	200	g/min	GB/T 29755-2013
固化条件	表面固化 @25℃	15	min
	完全固化 @25℃	6	H
	加速固化 @100℃	5	min
<b>硫化后</b>			
导热系数	1.0(±0.1)	W/m·K	ASTM D 5470
热阻	≤2.0 (@20psi&1mm)	°Cin <sup>2</sup> /W	ASTM D 5470
硬度	35(±5)	Shore C	ASTM D 2240
击穿电压	≥10	kV/mm	ASTM D 149
体积电阻率	≥10 <sup>12</sup>	Ω.cm	ASTM D 257
压缩比	≥50 (@50psi)	%	ASTM D 695
拉伸强度	≥0.6	MPa	ASTM D 412
延伸率	≥120	%	ASTM D 412
粘接强度	≥0.6	MPa	ASTM D 624
撕裂强度	≥1.6	KN/m	ASTM D 624
介电常数	≥2	@1MHz	ASTM D 150
介质损耗	≤0.1	@1MHz	ASTM D 150
防火性能	V0	--	UL 94
使用温度	-40~150	°C	IEC 60068-2-14

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权